

UV膠解離機



技術規格

外觀尺寸	2770(L)mm*4150(W)mm*2550(H)mm
重量	5140 kg
WPH	8 (For 8"/12")
晶圓尺寸	8"/12' Notch & Frame type
晶圓翹取	8"/12' Notch & Frame type
操作模式	Auto or Manual
載具	For 8" wafer: Magazine/ For 12" wafer: FOUP/Magazine

設備特性與優點

- 玻璃完整的移除。
- 晶圓無破裂、無裂痕。
- 膠膜的清除、無痕殘留。
- 避免BGA的殘缺，保持完整性。